

SPEC NUMBER:

205-03-212

取扱説明書 INSTRUCTON MANUAL

SERIES 5801
0.4 mm PITCH B to B CONNECTOR

						KYOCERA ELCO
Α	DCN-710	9/3 '08	T.Sasaki		K.Honda	Corporation
0	EDN-462	4/6 '05	T.Sasaki	H.Taguchi	N.Hayashi	ENGINEERING
No.	EDN/DCN	DATE	PREPARED	CHECK	APPROVED	DEPT.

		多	Contents	
٦.	はじめに Preface			 2
2.	部品名称及び型番 Parts na	nes and model	numbers	 2~3
3.	使用に関する注意事項 Matt	ers to be not	ced in use	 4 ~

1. はじめに Preface

5801シリーズは、市場における高密度実装化に対応すべく開発された 0.4mm ピッチボードツーボードコネクタです。

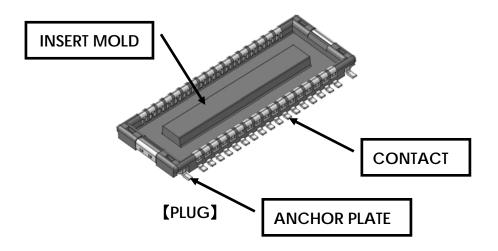
Series 5801 is a board—to—board connector with 0.4mm pitch, developed to meet the market's demand for the higher mountability.

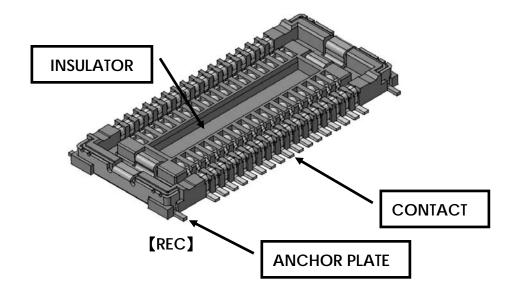
2. 部品名称及び型番 Parts names and model numbers

2.1 部品名称 Parts names

SERIES 5801

(0. 4mm PITCH B. TO B. CONNECTOR H=0. 8mm)

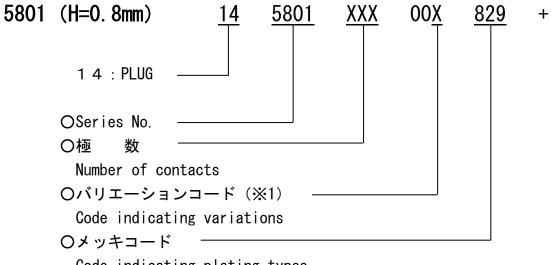




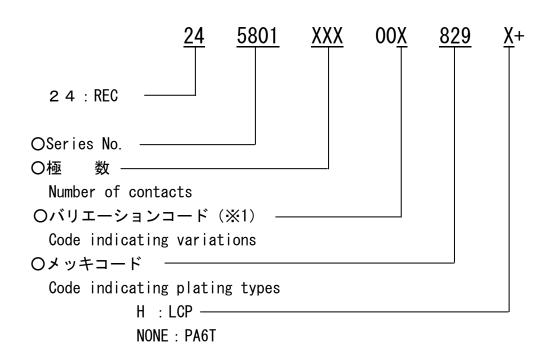
SERIES 5801 INSTRUCTION MANUAL SPEC No. 205-03-212

106-03-004 PAGE 2/11

2.2 型番 Model number



Code indicating plating types



※1

	METAL	BOSS
0	×	×
1	×	0
2	0	×
3	0	0

 SERIES 5801 INSTRUCTION MANUAL
 SPEC No. 205-03-212

 100 02 004
 PAGE 2/11

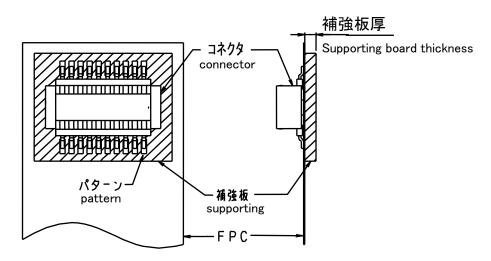
106-03-004 PAGE 3/11

- 3. 使用に関する注意事項 Matters to be noted in use
 - 3.1 FPC 使用に関して FPC use
 - (1)コネクタを挿抜する際、製品に直接負荷がかからないように FPC の裏面 に補強板を貼り付けた状態での使用をお願い致します。

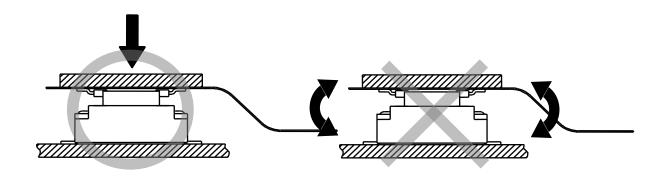
補強板仕様に関しましては弊社製品外形より大きいものを使用し、板厚については実践による確認をお願い致します。

Please make sure to attach reinforcing board to FPC's back, so that it will relieve the product from the stress caused by connector insertion /extraction.

Such reinforcing board should be bigger than our product, and its suitable thickness should be decided through actual test.



(2) 落下・衝撃や FPC 取り回しの際の反力が大きく加わることが懸念される場合はコネクタの嵌合方向への押さえによる固定をお勧め致します。 When such possibility as the product may fall, receive any impact or reaction force from being thrashed is expected, and then it is recommended to fix them in the direction of engagement.



SERIES 5801 INSTRUCTION MANUAL

SPEC No. 205-03-212

106-03-004 PAGE 4/11

3.2 実装に関して Mounting

(1) 実装の際には接触部及びテール部に不要な外力が加わり変形等が生じないようご注意お願い致します。

Please make sure that the product is free from deformity caused by the unnecessary stress to the contacting points and the tail.

(2) 自動実装の際には弊社推奨パターン図でのクリームはんだ印刷及び実装をお願い致します。

(詳細なプリント基板寸法に関しましては、弊社製品図面をご参考願います。) When the connectors are automatically mounted, please apply cream soldering printing in the process in accordance with the pattern chart of our recommendation.

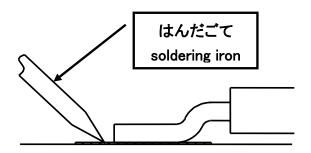
(For detailed dimensions of the printed circuit board, please refer to our product drawings.)

(3) 手付けはんだの際にはテール部及び基板へのフラックス塗布はしないで下さい。コネクタ内部及び接触部へのフラックス上がり及び飛散の原因となり接触不良等の不具合が発生する場合があります。

又、はんだごてで端子に負荷をかけてはんだ付けを行うとテール部変形 及びインシュレータの溶け等の恐れがありますのでご注意お願い致しま す。

Please do not apply flux onto the tail and PC board, when it is soldered manually. Splattered or migrated flux inside the connector or to the contact points may cause imperfect contact.

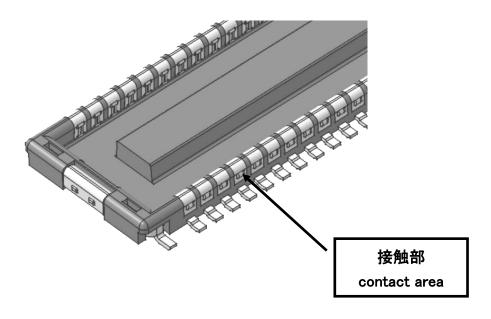
Also avoid giving any stress to the product with the soldering iron. It could deform tail or melt insulator.



106-03-004 PAGE 5/11

(4) PLUG 側は接点が外側にも露出している為、実装の際はフラックスの飛散にご注意お願い致します。

In the mounting process, special care is needed so that the exposed contact points on the plug side will be free from splattered flux.



106-03-004 PAGE 6/11

3.3 嵌合に関して Engagement

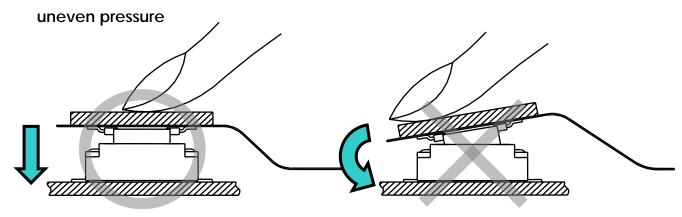
(1)コネクタの接触部に触れたり、異物を入れるとバネの変形等の原因となりますのでご注意お願い致します。

If something touches the contact points or with some foreign object, the spring could be deformed.

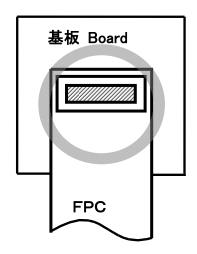
(2) 本製品は小型、軽量化をする為に成形品の肉厚を薄くしており、嵌合・ 離脱時に過度なこじり、ねじり挿抜は成形品の破壊、端子の変形、テール 部はんだ剥離の原因となりますので注意お願い致します。

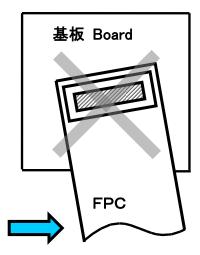
We minimized the thickness of this product to achieve downsizing and light weightiness. Because of this, uneven pressure or distorted attachment at engagement /disengagement could cause destruction, terminal deformity, plating detachment on the tail.

(こじり)



(ねじり) distorted attachment





SERIES 5801 INSTRUCTION MANUAL

SPEC No. 205-03-212

106-03-004 PAGE 7/11

3.4 チェッカーに関して Checker

貴社工程におきましてチェッカーとしてご使用になる場合、かならず 弊社指定のチェッカー治具用コネクタをご使用願います。

製品をそのままチェッカーとしてご使用する場合、耐久性が劣ること、

相手側製品に過度にダメージを与える場合がありますので、ご注意願います。

また、貴社独自のチェッカーをご使用の場合は事前にご連絡お願いいたします。 When you use them as a checker in your production process, please be sure to use our specified plug or receptacle for the checker. If the connectors targeted in this manual is used as a checker, please be informed that durability may not be high enough or the product to be checked could be damaged excessively.

When you use your original checker, please consult with us beforehand.

チェッカー治具用コネクタ型番

Part number of our specified plug/receptacle connector used as a checker. (1000plugs packed in a Tape & Reel)

PLUG

1 4 5801 XXX 90× 831 + (1000個巻)

SPEC No. 205-03-212

PAGE 8/11

106-03-004

3.5 洗浄に関して

貴社工程におきまして洗浄を実施する場合は、下記条件での洗浄を 推奨いたします。

Following cleansing condition should be recommended in case the cleansing is done in your production process.

<耐溶剤性試験条件 Test condition for resistance to solvent>

洗浄剤 : パインアルファ ST-100S (荒川化学社製)

成 分: ポリエチレングリコール(アルキルエーテル溶剤) 含有比率: 80 %

: ノンイオン 系界面活性剤 含有比率 : 15 %

: 純水 含有比率: 5%

洗浄工程及び条件

	洗浄	すすぎ	乾燥		
	ルザ	水切り		乾燥	
方式	温液超音波揺動	超音波揺動	エアーナイフ	温風フロー	
使用洗剤	パインアルファ	イソプロピル	 工場エアー	_	
使用液剤	ST-100 S	アルコール	工物一)		
温度	60°C	常温	常温	85°C	
時間	60秒間	120秒間	60秒間	10分間	

Solvent : PINE ALPHA ST 100S(ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES,LTD.)

Content : POLYETHYLENE-GLYCOL(Solvent classified as ALKYL-ETHER)

- Content ratio : 80 %

: NON-ION SYSTEM SURFACE-ACTIVE AGENT - Content ratio : 15 %

: PURE WATER - Content ratio : 5 %

Cleansing process and condition

	CI EANSING	WASHING	DRY	′ING
	CLEANSING	WASHING	WIPING	DRYING
SYSTEM	Up and down movement in hot liquid with ultrasonic wave	Up and down movement with ultrasonic wave	Air knife	Warm blow
Detergent Liquid Medicine	PINE ALPHA ST-100 S	ISOPROPYL ALCOHOL	Industrial air	-
Tempe- rature	60 ℃	Normal temperature	Normal temperature	85 °C
TIME	60 sec.	120 sec.	60 sec.	10 min.

 SERIES 5801 INSTRUCTION MANUAL
 SPEC No. 205-03-212

 106-03-004
 PAGE 9/11

3.6 プリント基板及び、メタルマスク開口部推奨寸法に関して

Printed Circuit Board and Recommended Dimensions of the Opening Area in the Metal Mask

本コネクタは、ピッチ間隔が 0.4mm であり高密度実装が要求されるコネクタとなってお ります。高密度実装が要求されるコネクタに関しては、半田ブリッジによるショート等の 実装不具合を減らすために適正な半田量の管理が必要となります。

つきましては、添付推奨寸法図をご参考願います。

(詳細なプリント基板寸法に関しましては、弊社製品図面をご参考願います。)

特に、PLUG 保持金具部の半田量が多い場合は RECE ソケットと干渉し、不完全嵌 合の原因となりますので注意願います。

プリント基板及び、メタルマスク開口部寸法は**推奨**ですので不明点及び、懸念点 等がございましたら相談いただけますよう御願い致します。

This series of connector is required to be mounted in the high density due to its 0.4mm pitches. The connectors mounted in the high density need to be controlled adequate amount of solder in order to prevent failures in the mounting process such as short-circuit caused by solder bridge.

For the dimensions of the metal mask opening, therefore, please refer to our recommended dimensions shown in the attached drawing.

(For detailed dimensions of the printed circuit board, please refer to our product drawings.)

If excessive solder is applied on the retaining metal of the plug connector, especially, it interferes with the receptacle connector, which leads to incomplete mate of the connectors.

As dimensions shown in the drawings are our **recommendation**.

Please feel free to contact us if you have any questions and/or concerns about these dimensions.

SPEC No. 205-03-212

Series 5801: 0.4 mm Pitch

Recommended Pad & Stencil size (SIGNAL CONTACT)

	<u>PLUG</u>	<u>RECE</u>	
<u>Pad</u>	0. 23mm (9m i 1)	1.0mm (39.4mil) (39.4mil)	
<u>Stencil</u>	0. 23mm (9mi I) (1	0. 23mm (9mil) (1 i m y . (32) t=0. 12mm	